

SPIS TREŚCI

Rozdział	stronica
Przedmowa ^{N2)}	2
1 Zakres normy.....	4
2 Powołania normatywne	4
3 Terminy i definicje	4
4 Akronimy.....	5
5 Metody badania jakości połączeń lutowanych.....	5
5.1 Badanie lutowności w warunkach lutowania rozplwowego, przeznaczone dla połączeń lutowanych.....	5
5.2 Zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości.....	8
6 Metody badań mechanicznych	8
6.1 Badanie wytrzymałości połączenia lutowanego na zginanie	8
6.2 Badanie wytrzymałości połączenia lutowanego na upuszczanie.....	8
7 Metody badań środowiskowych.....	8
7.1 Badanie połączenia lutowanego na działanie cyklicznych zmian temperatury	8
7.2 Zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości.....	11
Załącznik A (informacyjny) Informacyjne metody badań dotyczące kontrolnej płytki drukowanej – Wytyczne	12
Załącznik B (informacyjny) Znornalizowany proces montażu obudów matrycowych i obudów z wyprowadzeniami rozmieszczonymi na obwodzie spodu obudowy (QFN i SON).....	23
Bibliografia.....	26
Rysunek 1 – Pomiar temperatury próbki za pomocą termopar	7
Rysunek 2 – Proponowany cykl procesu nawilżania/rozplwu.....	7
Rysunek 3 – Charakterystyka temperaturowo-czasowa lutowania rozplwowego	7
Rysunek 4 – Konfiguracja przebiegu jednego cyklu.....	10
Rysunek A.1 – Pomiar temperatury próbki za pomocą termopar	13
Rysunek A.2 – Pomiar temperatury próbki za pomocą termopar	15
Rysunek A.3 – Metody pomiaru stosowane w badaniu wytrzymałości na odrywanie	17
Rysunek A.4 – Znornalizowany kształt pola płytki kontrolnej do badania niezawodności montażu	20
Rysunek A.5 – Znornalizowany projekt dotyczący kształtu pola lutowniczego dla obudów z wyprowadzeniami rozmieszczonymi na obwodzie spodu obudowy, typu SON i QFN	21
Tablica 1 – Warunki próby cyklicznych zmian temperatury	10
Tablica A.1 – Typy płytki kontrolnej do badania niezawodności montażu	19
Tablica A.2 – Znornalizowana konfiguracja warstw płytki kontrolnej do badania niezawodności montażu ..	20
Tablica A.3 – Wytyczne projektowe dotyczące wielkości pól dla obudów matrycowych typu BGA, FBGA, LGA i FLGA z wyprowadzeniami sferycznymi/płaskimi podwyższonymi.....	21
Tablica B.1 – Znornalizowany projekt szablonu dla obudów matrycowych	23
Tablica B.2 – Znornalizowany projekt szablonu dla obudów z wyprowadzeniami rozmieszczonymi na obwodzie spodu obudowy	23

^{N2)} Odsyłacz krajowy: Przedmowę do normy IEC pominięto.